



(21)申請案號：106207992

(22)申請日：中華民國 106 (2017) 年 06 月 05 日

(51)Int. Cl. : **B65B61/18 (2006.01)**

(71)申請人：林世峯(中華民國) (TW)

新北市三峽區正義街 79 號

(72)新型創作人：林世峯 (TW)

申請專利範圍項數：6 項 圖式數：21 共 30 頁

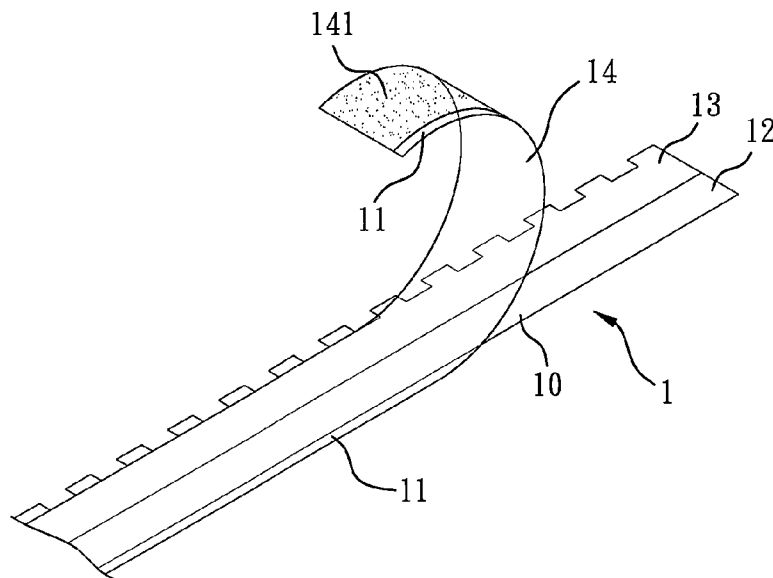
(54)名稱

可快速封裝與開啟包裝體的封裝帶

(57)摘要

一種可快速封裝與開啟包裝體的封裝帶，係在一長條狀的離形基材沿著其長度形成有彼此平行的一第一分離撕開線與一第二分離撕開線，一第一撕離部與一第二撕離部；將在一側面部份塗覆有黏膠層的封裝膠帶黏貼於該離形基材的第一側面，進而在離形基材第一分離撕開線側邊則設有與封裝膠帶一體的一無黏膠層的封裝帶撕開條，該第一撕離部可從該離形基材的第二側面撕離而露出該黏膠層以形成一第一黏貼面，該第一黏貼面可用於黏貼在一包裝體的本體或覆蓋部上，從離形基材的第二側面撕開第二撕離部而露出該黏膠層以形成一第二黏貼面，藉由該第二黏貼面黏貼於包裝體或覆蓋部而完成封裝，該無黏膠層的封裝帶撕開條提供從包裝體快速撕開封裝膠帶之用。

指定代表圖：



第二圖

符號簡單說明：

1 . . . 封裝帶

10 . . . 離形基材

11 . . . 封裝帶撕開條

12 . . . 第一撕離部

13 . . . 第二撕離部

14 . . . 封裝膠帶

141 . . . 黏膠層

公告本

新型摘要

※ 申請案號：106207992

※ 申請日：106/06/05

※IPC 分類：B65B 61/18 (2006.01)

【新型名稱】(中文/英文)

可快速封裝與開啟包裝體的封裝帶

【中文】

一種可快速封裝與開啟包裝體的封裝帶，係在一長條狀的離形基材沿著其長度形成有彼此平行的一第一分離撕開線與一第二分離撕開線，一第一撕離部與一第二撕離部；將在一側面部份塗覆有黏膠層的封裝膠帶黏貼於該離形基材的第一側面，進而在離形基材第一分離撕開線側邊則設有與封裝膠帶一體的一無黏膠層的封裝帶撕開條，該第一撕離部可從該離形基材的第二側面撕離而露出該黏膠層以形成一第一黏貼面，該第一黏貼面可用於黏貼在一包裝體的本體或覆蓋部上，從離形基材的第二側面撕開第二撕離部而露出該黏膠層以形成一第二黏貼面，藉由該第二黏貼面黏貼於包裝體或覆蓋部而完成封裝，該無黏膠層的封裝帶撕開條提供從包裝體快速撕開封裝膠帶之用。

【英文】

【代表圖】

【本案指定代表圖】：第（二）圖。

【本代表圖之符號簡單說明】：

1.....封裝帶

10.....離形基材

11.....封裝帶撕開條

12.....第一撕離部

13.....第二撕離部

14.....封裝膠帶

141.....黏膠層

新型專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動)

【新型名稱】(中文/英文)

可快速封裝與開啟包裝體的封裝帶

【技術領域】

【0001】本創作涉及一種紙製包裝體的包裝元件，特別是一種可以快速封裝與快速開啟的封裝帶。

【先前技術】

【0002】隨著網路技術的發達，電子商務的成長也日益紅火；電子商務業者將貨品交由貨運業者遞送之前必須以包裝箱做妥善包裝，其包裝時，一般係將貨品放入包裝箱、盒、袋.....等(以下統稱包裝體)，然後將包裝體的蓋板覆蓋後再以膠帶將其黏貼封裝；其他的郵遞業務也大致如此。

【0003】當消費者收到包裹後欲開啟時則必須將膠帶撕下或以刀具將膠帶割開，但無論是撕下或割開膠帶，都會造成包裝箱體不同程度的破壞，致使包裝體不易再被回收重複使用，尤其是消費者在鑑賞期內後悔不想買而要退貨時更是感到困擾，因此，損壞的包裝體會因此無法再使用而直接被丟棄，造成資源浪費，也因為包裝體殘留的膠帶會造成環保資源回收業者，回收包裝體製造再生紙時，處理包裝體上殘留膠帶串所增加的費用及處理工序，不符環保要求。

【新型內容】

【0004】本創作的目的，在於提供一種可以快速結合於包裝體以及快速從包裝體撕開的封裝膠帶。

【0005】 本創作的特徵，係在一長條狀的離形基材沿著其長度形成有彼此平行的一第一分離撕開線與一第二分離撕開線，一第一撕離部與一第二撕離部；將在一側面部份塗覆有黏膠層，部份則設有無黏膠層的封裝膠帶黏貼於該離形基材的第一側面，進而在離形基材第一分離撕開線側邊形成一無黏膠層的封裝帶撕開條，該第一撕離部可從該離形基材的第二側面撕離而露出該黏膠層以形成一第一黏貼面，該第一黏貼面可用於黏貼在一包裝體的本體或覆蓋部上，從離形基材的第二側面撕開第二撕離部而露出該黏膠層以形成一第二黏貼面，藉由該第二黏貼面黏貼於包裝體或覆蓋部而完成封裝，該無黏膠層的封裝帶撕開條提供從包裝體快速撕開封裝膠帶之用。

【0006】 本創作提供的可快速封裝與開啟包裝體的封裝帶，其技術手段係包括：一離形基材，係延伸為連續的長條狀，沿著該離形基材的長度形成有彼此平行的一第一分離撕開線與一第二分離撕開線，該第一分離撕開線與離形基材的一長度側邊之間則設有與封裝膠帶一體的一無黏膠層的封裝帶撕開條，該第一分離撕開線與第二分離撕開線之間構成一第一撕離部，該第二分離撕開線與離形基材的另一長度側邊之間構成一第二撕離部；一封裝膠帶，其一側面的一部份塗覆有黏膠層，一部份則設有無黏膠層的封裝膠帶撕開條，該黏膠層黏貼於離形基材的第一側面的第一撕離部與第二撕離部，第一撕離部可從離形基材的第二側面沿著第一分離撕開線與第二分離撕開線被撕離而露出黏膠層以形成一第一黏貼面，從離形基材的第二側面撕開第二撕離部而露出黏膠層以形成一第二黏貼面。

【0007】 較佳者，本創作之第二撕離部的長度方向的側邊形成有複數個往該第二撕離部的寬度方向突出的凸出部，藉以讓使用者可以容易撥離第二撕離部。

【0008】 較佳者，本創作係使封裝膠帶的一側面的一部份塗覆有黏膠層，一部份則設有無黏膠層的封裝帶撕開條，藉此無黏膠層的封裝帶撕開

條讓使用者能夠容易撕除封裝膠帶。

【0009】較佳者，本創作係將封裝膠帶的黏膠層完全覆蓋第一撕離部與第二撕離部，藉此使離形基材可以牢靠地黏貼於包裝體上。

【0010】較佳者，本創作係使封裝膠帶的黏膠層沒有覆蓋第二撕離部的凸出部，藉此能夠容易撥離第二撕離部。

【0011】本創作的封裝膠帶可以採用透明膠帶，以避免遮蔽包裝體上印刷的文字或圖案。

【0012】本創作的封裝膠帶也可以採用不透明膠帶。

【0013】相較於習知的包裝體封裝結構，本創作藉由將封裝膠帶直接黏貼在離形基材的第一側面，使用時直接從離形基材的第二側面撕開部分離形基材即可將封裝帶黏貼於包裝體，並且進一步封裝包裝體，更可快速地将無黏膠層的封裝膠帶從包裝體撕開。

【圖式簡單說明】

【0014】

第一圖為顯示本創作之離形基材結構之平面示意圖；

第二圖為顯示本創作在第一圖之離形基材的第一側面黏貼封裝膠帶之實施例立體示意圖；

第三圖為顯示本創作將第二圖之離形基材的第二側面翻轉過來，並且撕開第一撕離部之實施例立體示意圖；

第四圖為顯示將第三圖之第一撕離部完全撕開後之實施例立體示意圖；

第五圖為顯示將第四圖之封裝帶黏貼於包裝箱之實施例立體示意圖；

第六圖為顯示將第五圖之封裝帶黏貼於包裝箱外側壁後之實施例立體示意圖；

第七圖為顯示將第六圖之第二撕離部撕開之實施例立體示意圖；

第八圖為顯示將第七圖之封裝帶的黏膠層黏貼於包裝體之實施例立體示意圖；

第九圖為顯示將第八圖之封裝膠帶撕開時之實施例立體示意圖；

第十圖為顯示將第九圖之包裝箱完全打開之實施例立體示意圖；

第十一圖為顯示將第四圖之封裝帶黏貼於包裝箱之第一主蓋板之實施例立體示意圖；

第十二圖為顯示將第十一圖之封裝帶黏貼於包裝箱之第一主蓋板後之實施例立體示意圖；

第十三圖為顯示將第十二圖之第二撕離部撕開時之實施例立體示意圖；

第十四圖為顯示將第十三圖之包裝箱的第一主蓋板覆蓋並黏貼於包裝箱上之實施例立體示意圖；

第十五圖為顯示將第十四圖之離形基材撕開時之實施例立體示意圖；

第十六圖為顯示將第四圖之封裝帶黏貼於包裝袋之實施例立體示意圖；

第十七圖為顯示將第十六圖之封裝帶黏貼於包裝袋後之實施例立體示意圖；

第十八圖為顯示將第十七圖之第二撕離部撕開時之實施例立體示意圖；

第十九圖為顯示將第十八圖之包裝袋封蓋對摺黏貼於包裝袋之實施例立體示意圖；

第二十圖為顯示將第十九圖之封裝帶撕開之實施例立體示意圖；以及

第二十一圖為顯示將第二十圖之封裝膠帶完全撕開以開啟包裝袋之實施例立體示意圖。

【實施方式】

【0015】以下配合圖式及元件符號對本創作之實施方式做更詳細的說明，俾使熟習該項技藝者在閱讀本說明書後能據以實施。

【0016】如第一圖與第二圖所示，本創作提供的可快速封裝與開啟包裝體的封裝帶 1，其較佳實施例包括有一離形基材 10 與一封裝膠帶 14；其中，該離形基材 10 係採用不易被膠著劑黏著的適當材料所製成，可延伸為連續的長條狀，並且可以被捲繞成捆而便於儲存、運輸及加工；該離形基材 10 沿著其長度形成有彼此平行的一第一分離撕開線 101 與一第二分離撕開線 102，第一分離撕開線 101 與第二分離撕開線 102 之間構成一第一撕離部 12，第二分離撕開線 102 與離形基材 10 的另一長度側邊之間構成一第二撕離部 13；其中，第二撕離部 13 的長度方向的側邊形成有複數個往該第二撕離部 13 的寬度方向突出的凸出部 131，該凸出部 131 可以是任何一種適當的形狀，該等凸出部 131 可為等間距地分佈；該第一撕離部 12 與第二撕離部 13 的寬度均大於無黏膠層的封裝帶撕開條 11 的寬度。

【0017】如第二圖所示，所述封裝膠帶 14 的寬度較佳地對應第一撕離部 12 與第二撕離部 13 的寬度總和但不包含凸出部 131 的寬度，並且在封裝膠帶 14 的一側面塗覆有黏膠層 141，該黏膠層 141 並不包含封裝帶撕開條 11，本創作係將黏膠層 141 完全覆蓋並黏貼於離形基材 10 之第一側面的第一撕離部 12 與第二撕離部 13 上，封裝帶撕開條 11 由於沒有塗覆有黏膠層 141，因此可以方便使用者從封裝帶撕開條 11 處撕除封裝膠帶 14。

【0018】第三圖至第十五圖為顯示將本創作之封裝帶 1 實際應用在包裝箱 2 之示意圖，其中，如第十圖所示，包裝箱 2 包含有連接在箱體之上端開口相對兩對兩側的第一主蓋板 21 與第二主蓋板 22，以及連接在箱體上端開口另外相對兩側的第一副蓋板 23 與第二副蓋板 24。進行包裝箱 2 的封裝時，先將第一副蓋板 23 與第二副蓋板 24 覆蓋於箱體上後，再將第一主蓋板 21 與第二主蓋板 22 依序覆蓋於第一、二副蓋板 23、24 上(如第五圖所示)。然後，將封裝帶 1 的翻轉過來露出離形基材 10 的第二側面(如第三圖

所示)，此時，第一撕離部 12 可從離形基材 10 的第二側面沿著第一分離撕開線 101 與第二分離撕開線 102 被撕離而露出黏膠層 141 做為第一黏貼面 121(如第四圖所示)，再將第一黏貼面 121 黏貼在包裝箱 2 的箱體外側(如第五圖與第六圖所示)，然後從離形基材 10 的第二側面撕開第二撕離部 12 而露出黏膠層 141 以做為第二黏貼面 132(如第七圖所示)，再將第二黏貼面 132 黏貼於包裝箱 2 的第二主蓋板 22 上而完成封裝(如第八圖所示)。當要開啟包裝箱 2 時，則可從無黏膠層的封裝帶撕開條 11 快速撕開封裝膠帶 14(如第九圖所示)，從而打開包裝箱 2(如第十圖所示)。

【0019】有些包裝箱 2 的第一主蓋板 21 和第二主蓋板 22 係相互對開的形式(如第十一圖所示)，因此，在封裝此種包裝箱時，係將撕開第一撕離部而露出第一黏貼部 121 的封裝帶 1 黏貼於第一主蓋板 21 的外表面(如第十二圖所示)，然後從離形基材 10 的第二側面撕開第二撕離部 12 而露出黏膠層 141 以做為第二黏貼面 132(如第十三圖所示)，再將第二黏貼面 132 黏貼於包裝箱 2 的第二主蓋板 22 上而完成封裝(如第十四圖所示)。當要開啟包裝箱 2 時，則可從無黏膠層的封裝帶撕開條 11 快速撕開封裝膠帶 14(如第十五圖所示)。

【0020】第十六圖至第二十一圖係顯示本創作之封裝帶 1 應用於文件遞送袋或包裝袋 3 之實施例立體示意圖；其中，該包裝袋 3 包含有一袋體與連接於袋口 30 處的封蓋 31，進行封裝時，將撕開第一撕離部 12 而露出第一黏貼部 121 的封裝帶 1 黏貼於包裝袋 3 的封蓋 31 的外表面(如第十六圖與第十七圖所示)，然後從離形基材 10 的第二側面撕開第二撕離部 12 而露出黏膠層 141 以做為第二黏貼面 132(如第十八圖所示)，再將封蓋 31 相對於包裝袋 3 對摺而使第二黏貼面 132 黏貼於包裝袋 3 上而完成封裝(如第十九圖所示)。當要開啟包裝袋 3 時，則可從無黏膠層的封裝帶撕開條 11 快速撕開封裝膠帶 14(如第二十圖所示)，從而露出袋口 30(如第二十一圖所示)。

【0021】以上所述者僅為用以解釋本創作之較佳實施例，並非企圖具以

對本創作做任何形式上之限制，是以，凡有在相同之創作精神下所作有關本創作之任何修飾或變更，皆仍應包括在本創作意圖保護之範疇。

【符號說明】

【0022】

- 1.....封裝帶
- 10.....離形基材
- 101.....第一分離撕開線
- 102.....第二分離撕開線
- 11.....封裝帶撕開條
- 12.....第一撕離部
- 121.....第一黏貼面
- 13.....第二撕離部
- 131.....凸出部
- 132.....第二黏貼面
- 14.....封裝膠帶
- 141.....黏膠層
- 2.....包裝箱
- 21.....第一主蓋板
- 22.....第二主蓋板
- 23.....第一副蓋板
- 24.....第二副蓋板
- 3.....包裝袋
- 30.....袋口
- 31.....封蓋

申請專利範圍

1. 一種可快速封裝與開啟包裝體的封裝帶，包括：

一離形基材，係延伸為連續的長條狀，沿著該離形基材的長度形成有彼此平行的一第一分離撕開線與一第二分離撕開線，該第一分離撕開線與該第二分離撕開線之間構成一第一撕離部，該第二分離撕開線與該離形基材的另一長度側邊之間構成一第二撕離部；

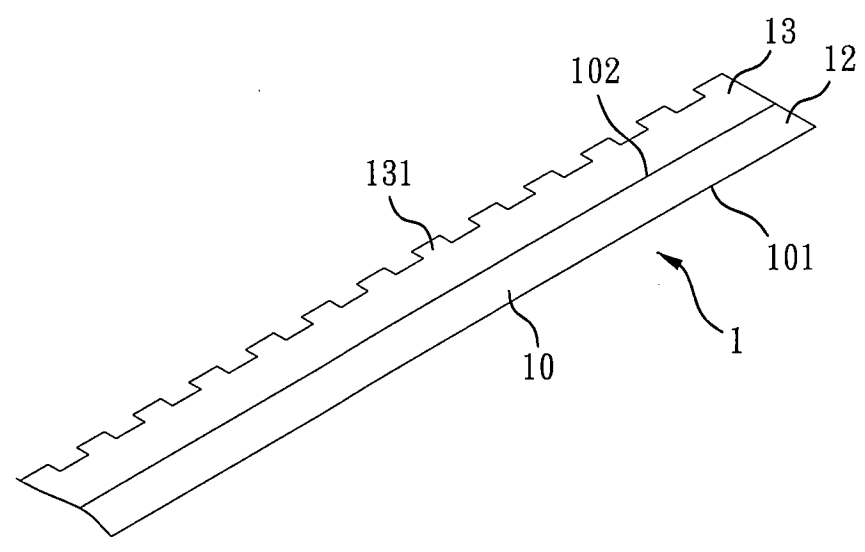
一封裝膠帶，其一側面一部份塗覆有黏膠層，一部份則設有無黏膠層的封裝帶撕開條，該黏膠層黏貼於該離形基材的第一側面並且覆蓋該第一撕離部與該第二撕離部，該第一撕離部可從該離形基材的第二側面沿著該第一分離撕開線與該第二分離撕開線被撕離而露出該黏膠層以形成一第一黏貼面，該第一黏貼面可用於黏貼在一包裝體的本體或覆蓋部上，從該離形基材的第二側面撕開該第二撕離部而露出該黏膠層以形成一第二黏貼面，藉由該第二黏貼面黏貼於該包裝體或該覆蓋部而完成封裝，設於封裝膠帶側邊的無黏膠層封裝帶撕開條提供從該包裝體快速撕開該封裝膠帶之用。

2. 依據申請專利範圍第 1 項所述之可快速封裝與開啟包裝體的封裝帶，其中，該第二撕離部的長度方向的側邊形成有複數個往該第二撕離部的寬度方向突出的凸出部。
3. 依據申請專利範圍第 2 項所述之可快速封裝與開啟包裝體的封裝帶，其中，該封裝膠帶的黏膠層沒有覆蓋該封裝帶撕開條。
4. 依據申請專利範圍第 3 項所述之可快速封裝與開啟包裝體的封裝帶，其中，該膠帶的黏膠層沒有覆蓋該凸出部。
5. 依據申請專利範圍第 1 項所述之可快速封裝與開啟包裝體的封裝帶，其

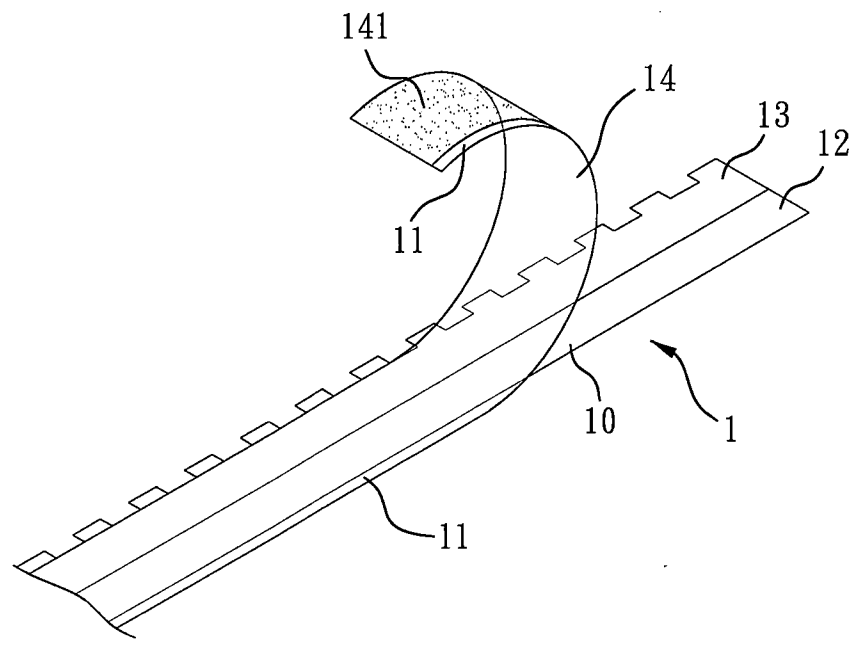
中，該封裝膠帶為透明。

6. 依據申請專利範圍第 1 項所述之可快速封裝與開啟包裝體的封裝帶，其中，該封裝膠帶為不透明。

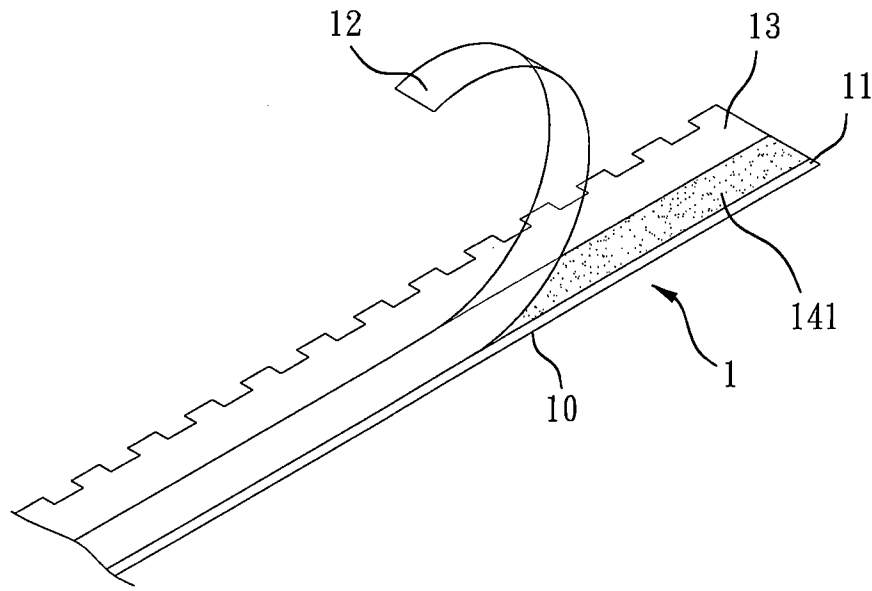
圖式



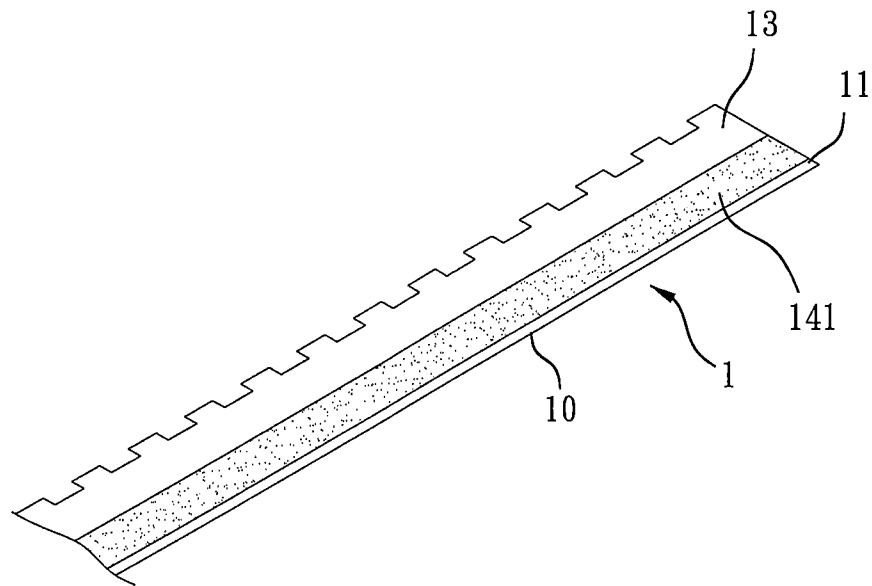
第一圖



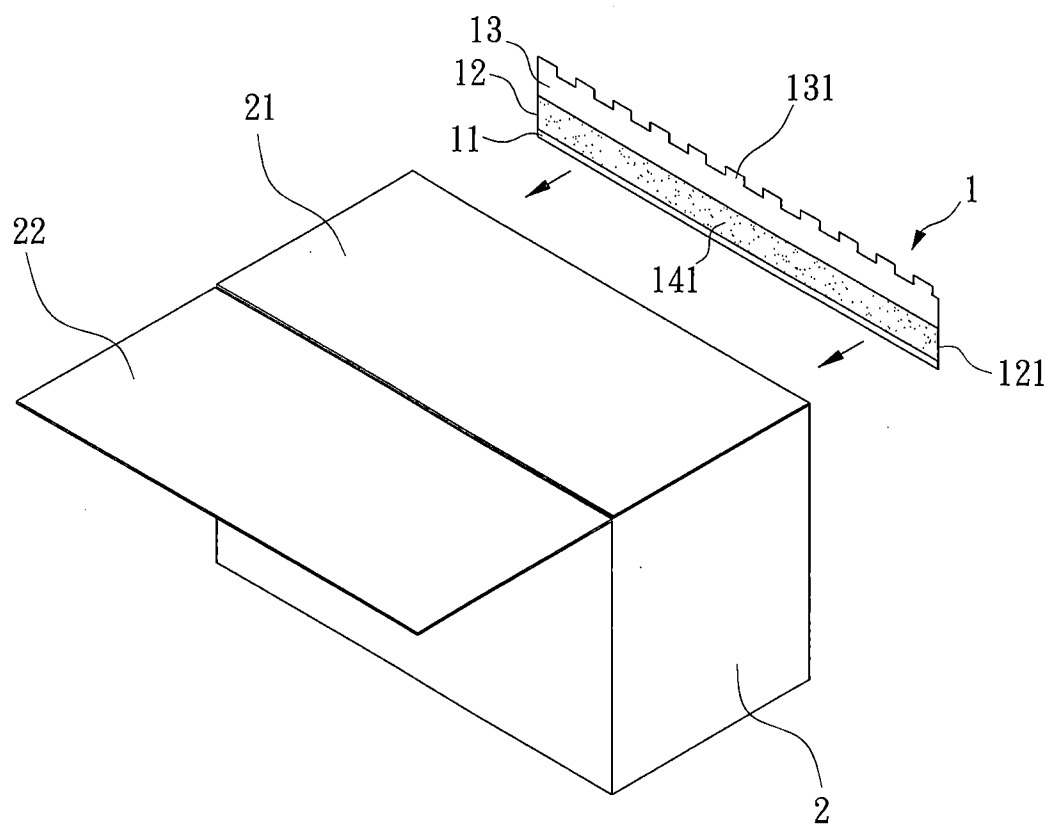
第二圖



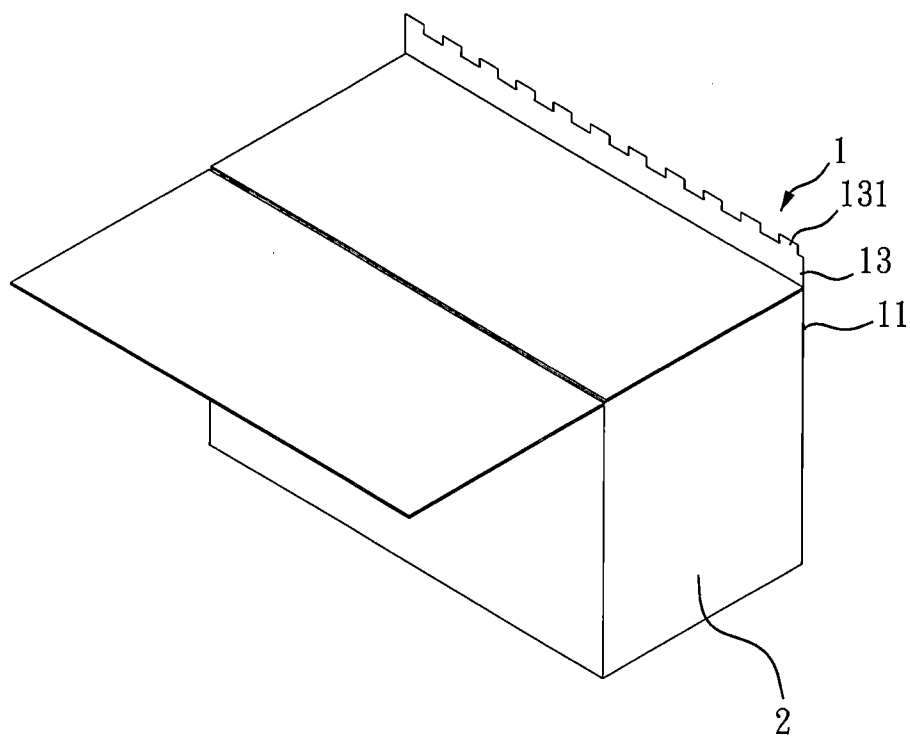
第三圖



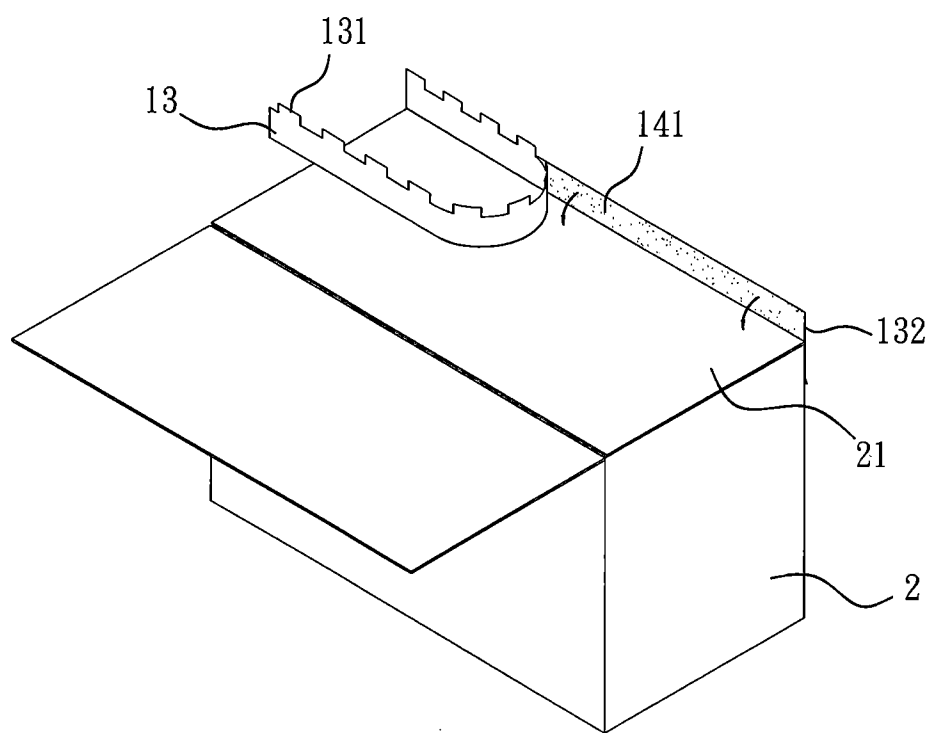
第四圖



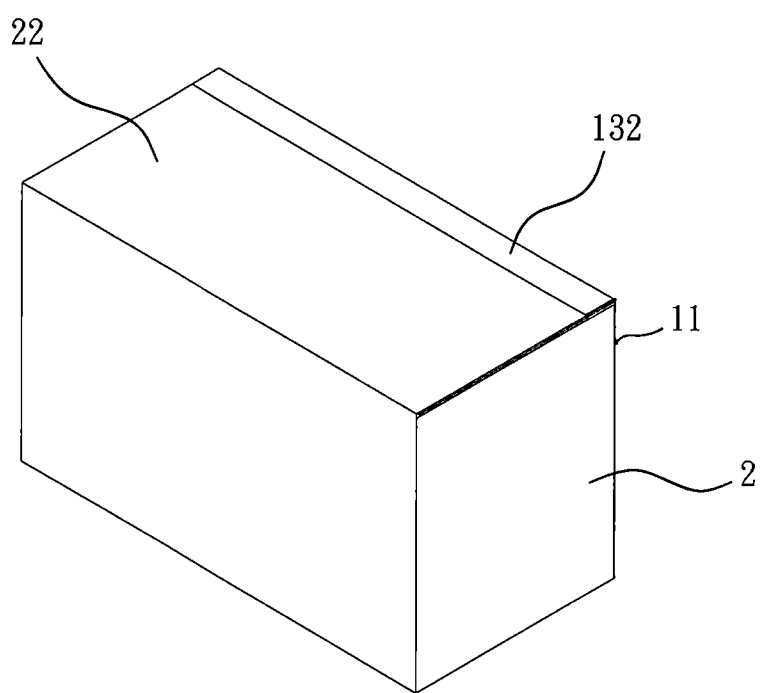
第五圖



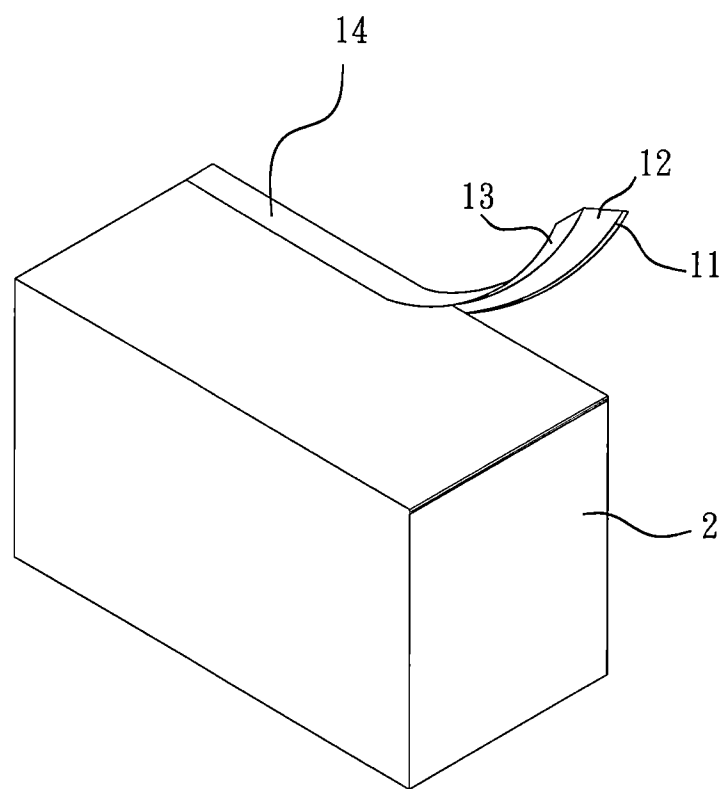
第六圖



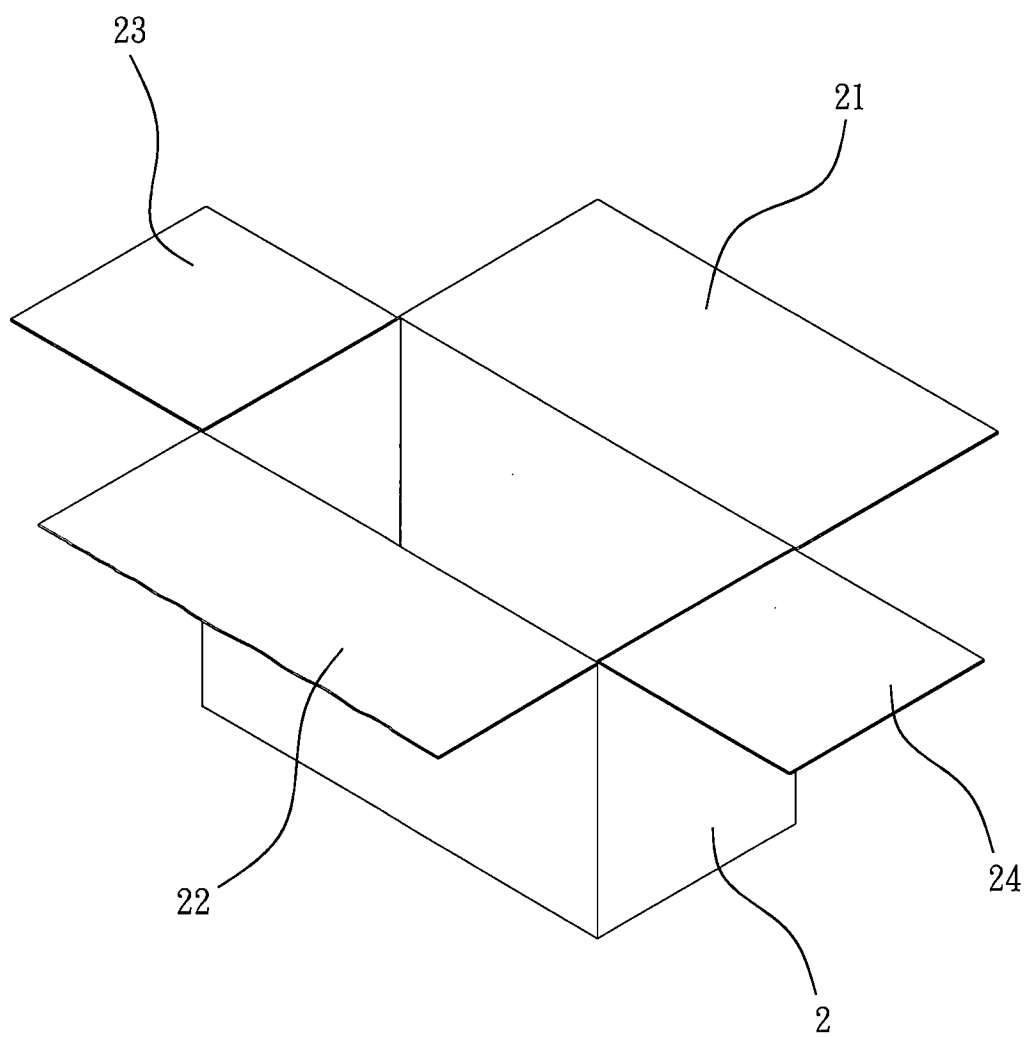
第七圖



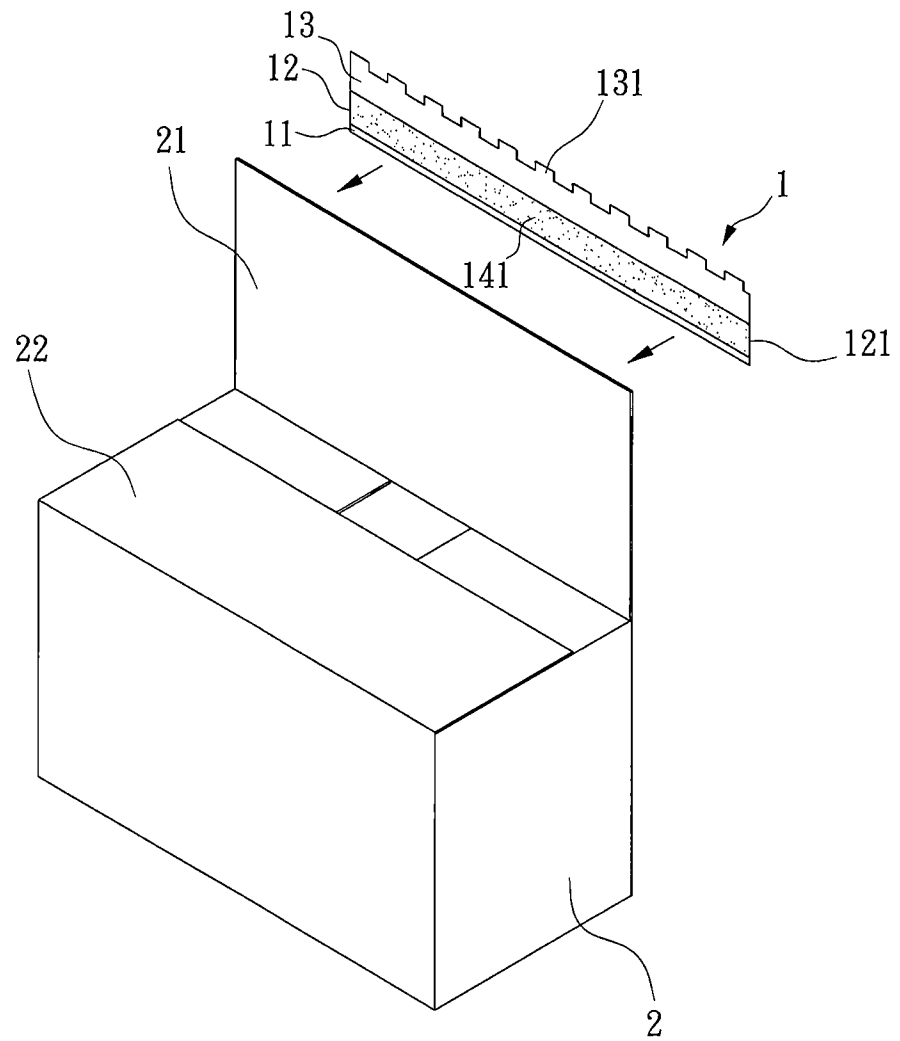
第八圖



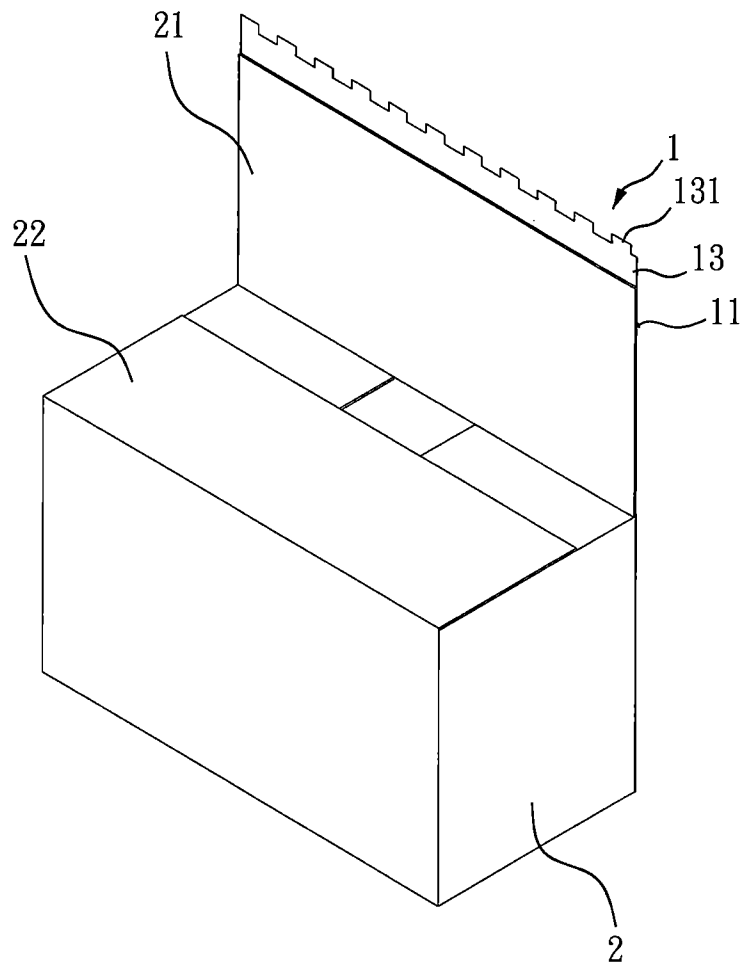
第九圖



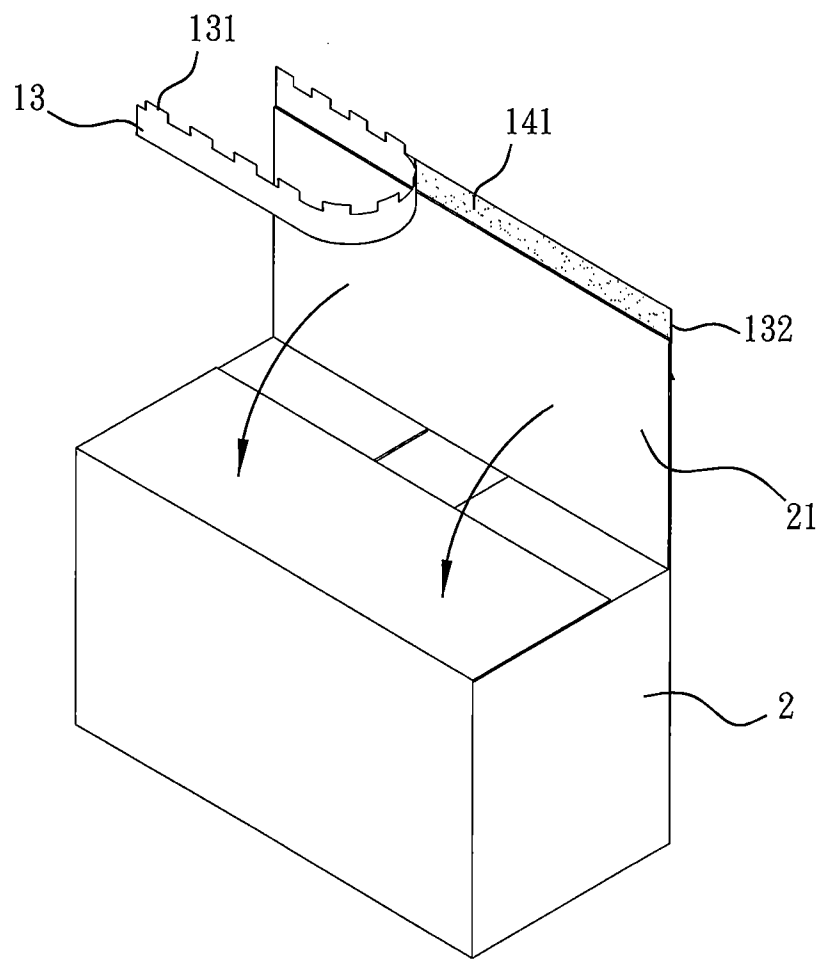
第十圖



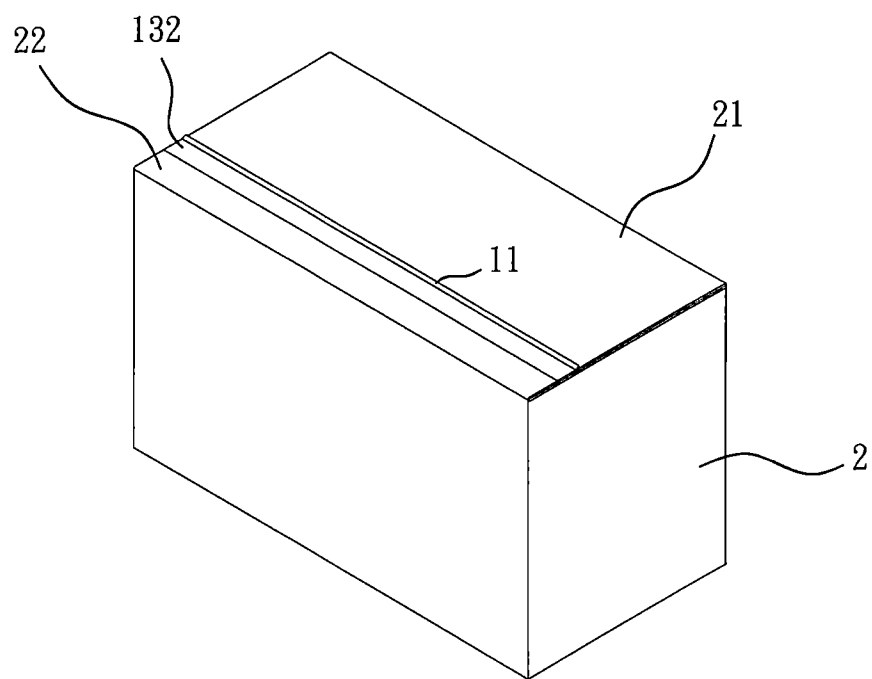
第十一圖



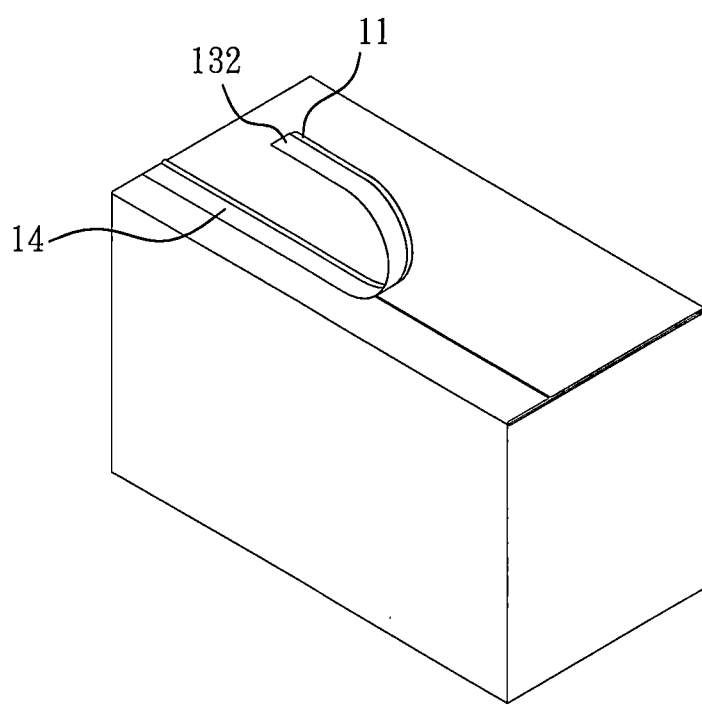
第十二圖



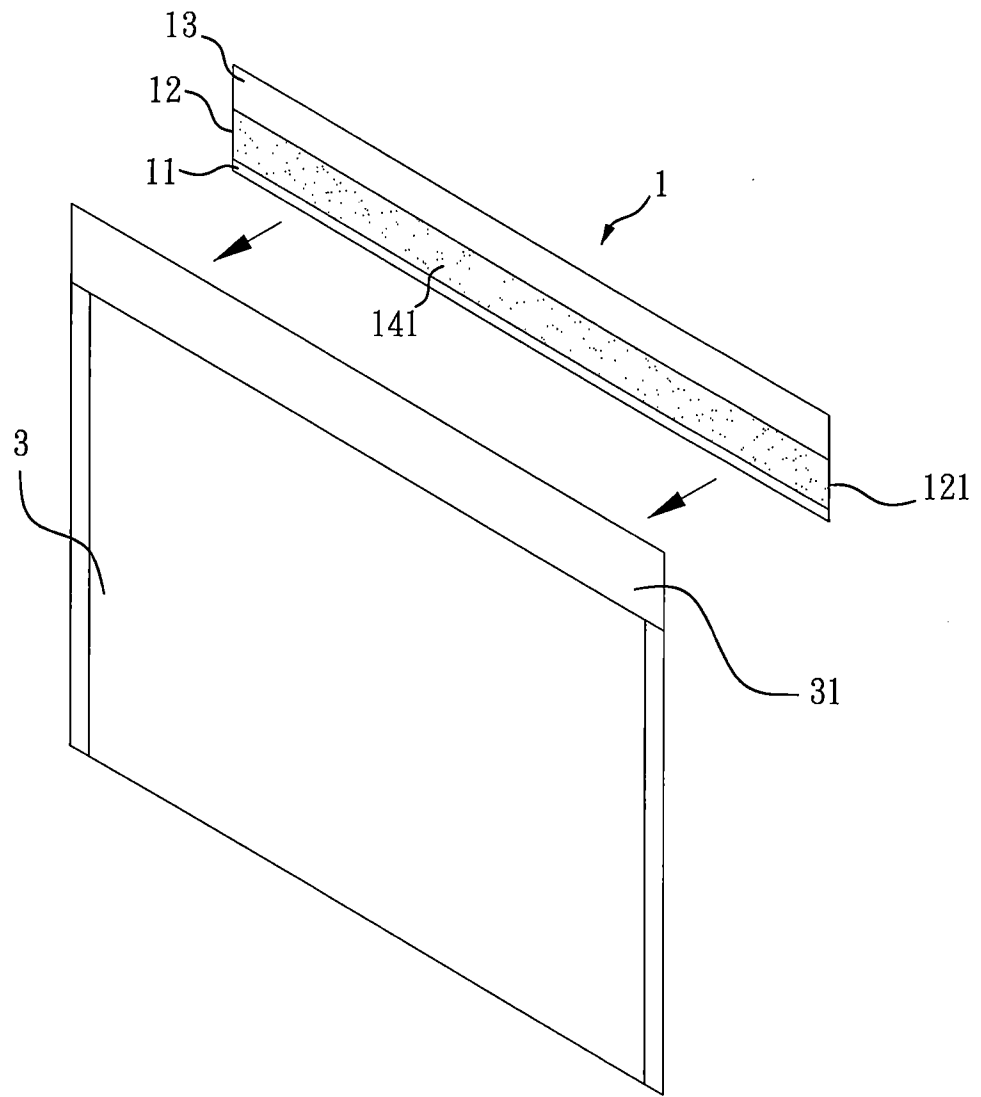
第十三圖



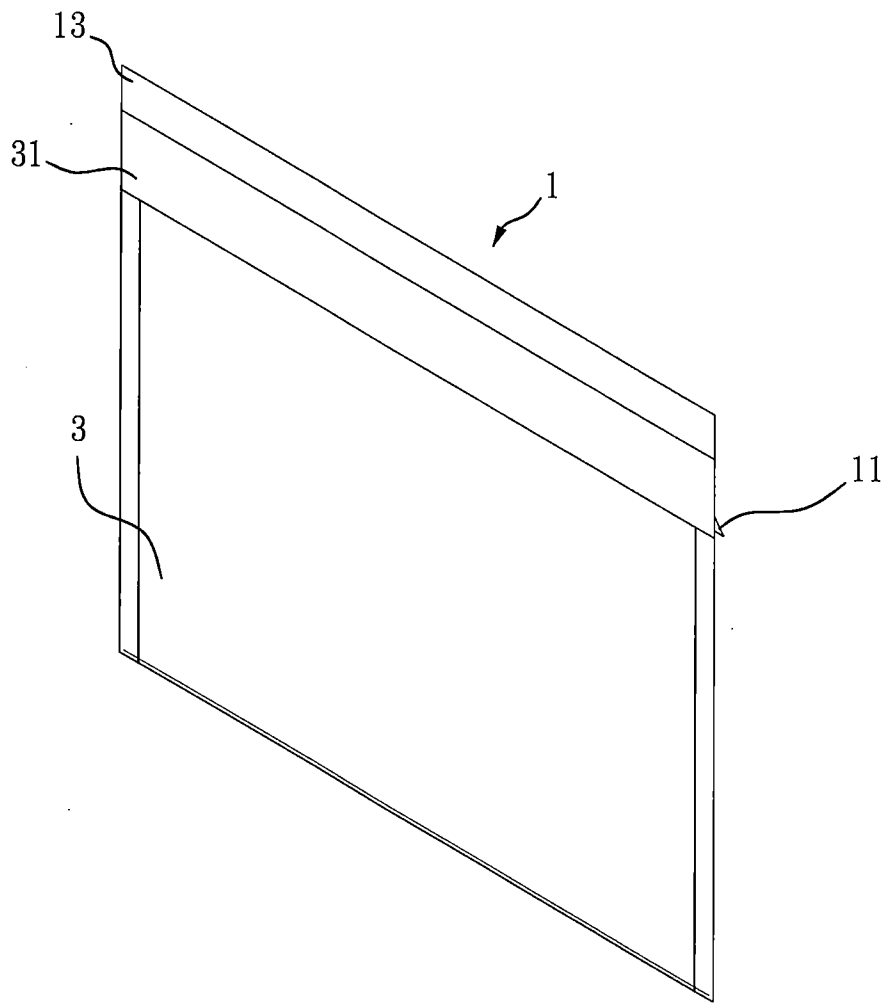
第十四圖



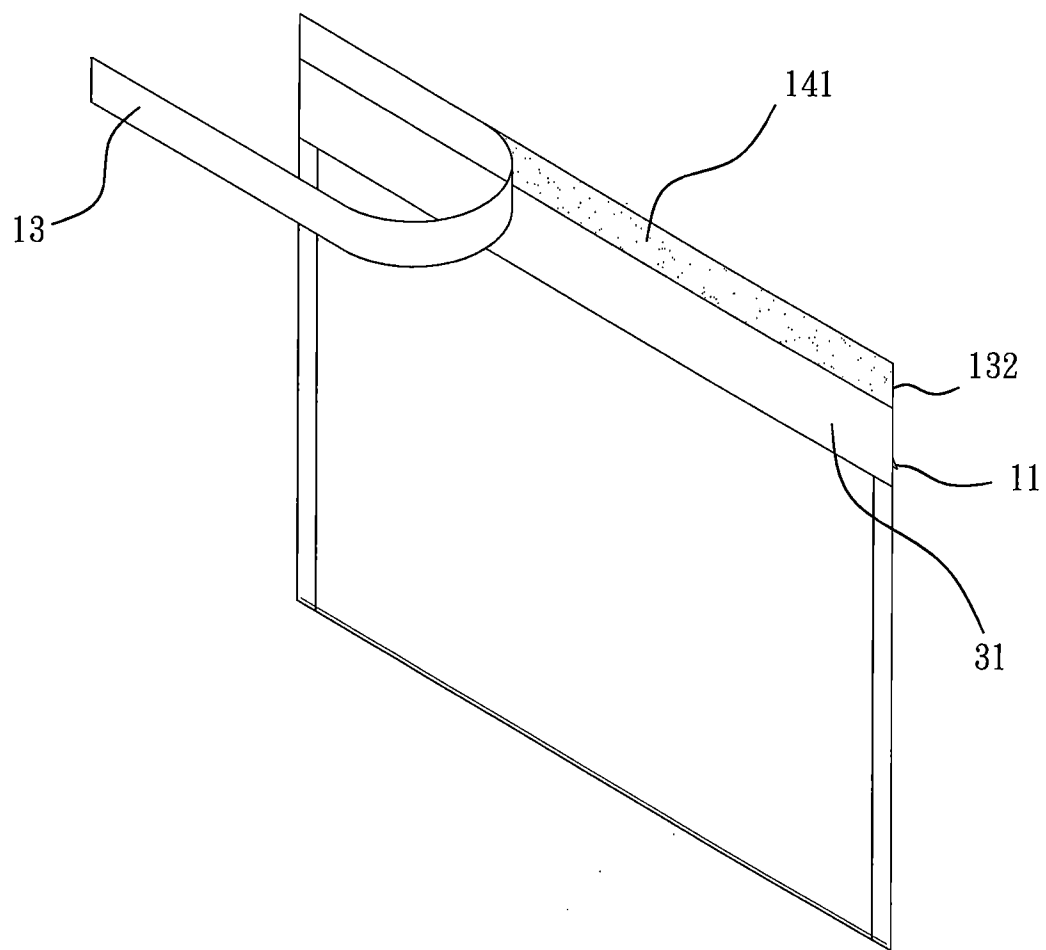
第十五圖



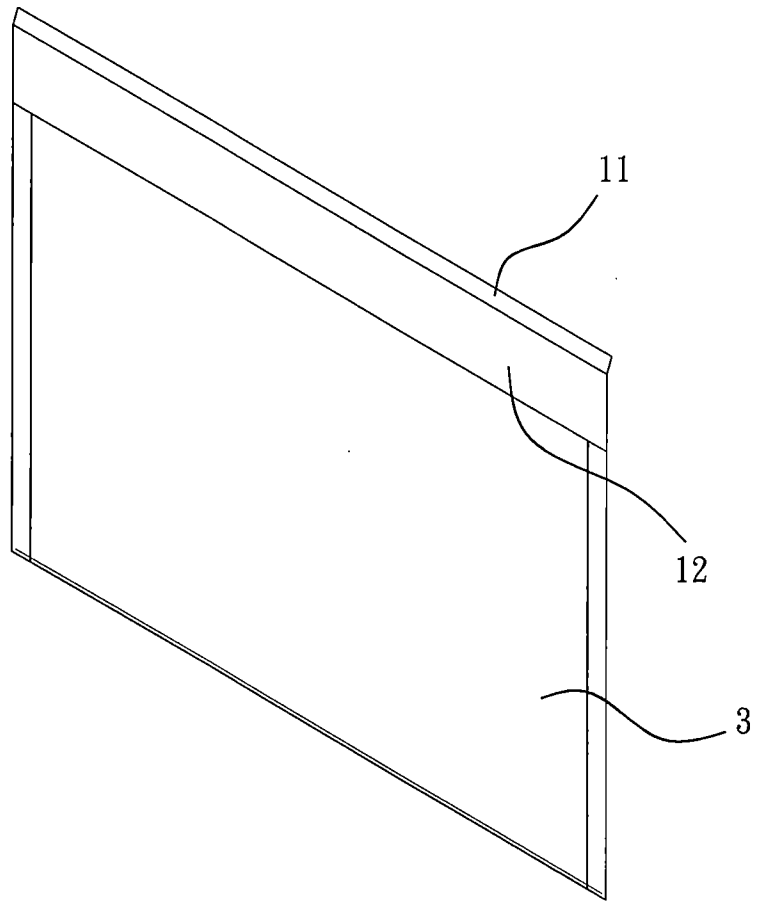
第十六圖



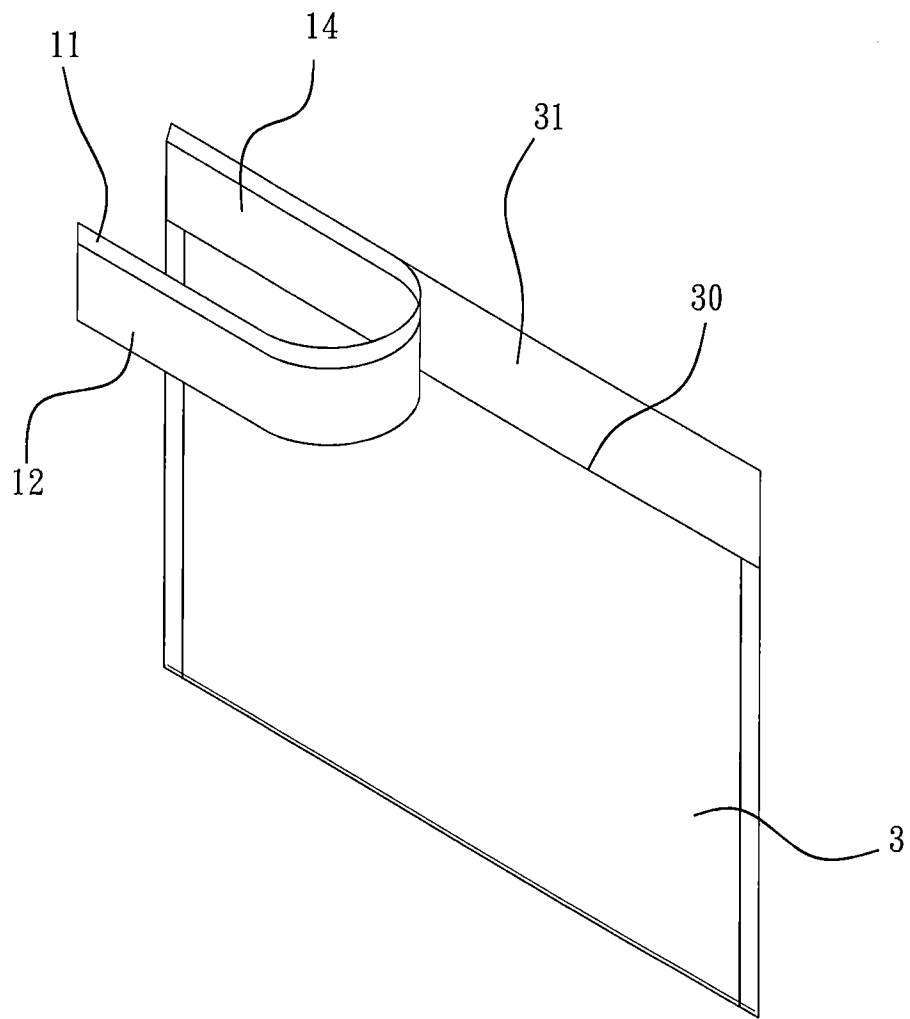
第十七圖



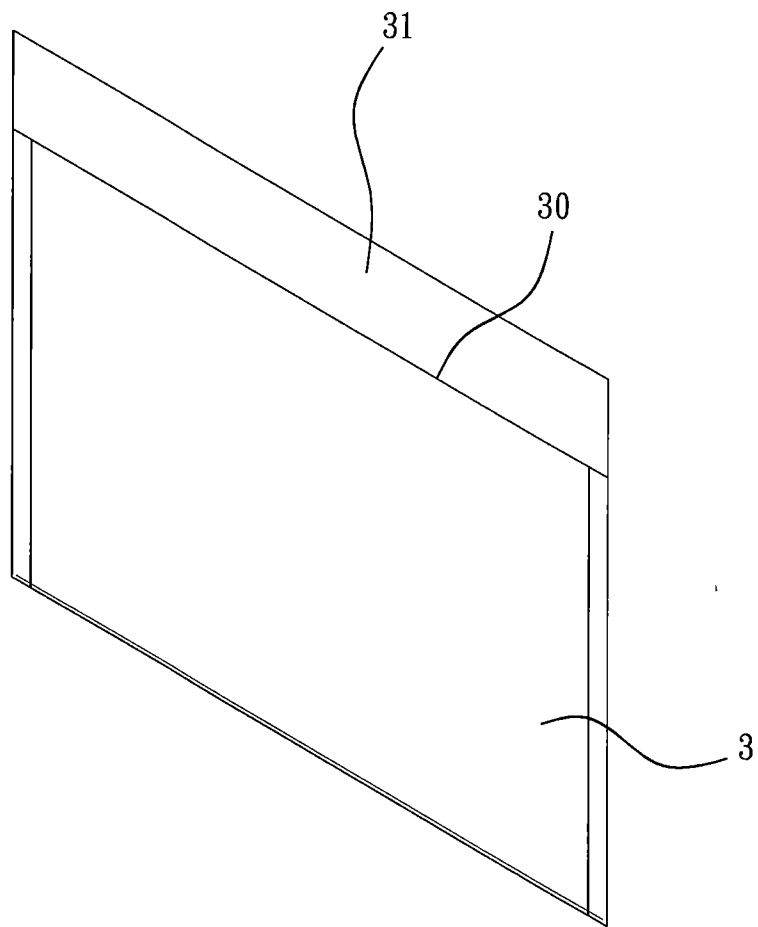
第十八圖



第十九圖



第二十圖



第二十一圖